

JCU REPORT

株主・投資家の皆様へ

第65期 中間報告書

2024.4.1 ▶ 2024.9.30 | 証券コード：4975

● トップインタビュー

中期経営計画策定、 2035年3月期売上高500億円へ 今期は増収増益見込み、 15期連続の増配を予定

2025年3月期の中間決算は増収増益となりました。

この度の中間決算は、半導体の在庫調整に改善の動きが見られたものの、厳しい事業環境が継続しました。こうした中、スマートフォンをはじめとする高機能電子デバイスの在庫が一巡したことから、プリント基板を中心に薬品需要が増加し、増収増益となりました。売上高、営業利益ともに計画通りの数値で着地でできており、通期の予想も売上高270億円、営業利益及び経常利益85億円、当期純利益59億円と据え置きました。株主配当は、安定した還元を重視する方針のもと、4円増配の年間74円と15期連続の増配を目指します。

2024年4月から新しい中期経営計画及び 10年スパンの長期ビジョンがスタートしました。

「JCU VISION 2035」では、2027年3月期までの「1st stage」、2030年3月期までの「2nd stage」、2035年3月期までの「3rd stage」と10年スパンにしたのが大きな特徴です。より長期的な視点から目指す姿を見据え、「2035年に目指す姿」を「独自の強みを最大限に活かし、環境や社会に貢献することで、社会とともに成長し続けるグローバル企業」と決めました。日々変化し続ける外部

環境に対応しつつ、常に技術・サービス体制を強化していくことで、社会価値と経済価値の追求による企業価値向上を図っていきます。「1st stage」では、成長分野への積極的な投資、経営基盤の強化、DX推進によるデータの利活用、既存市場における収益性強化、サステナビリティ経営の推進、人的資本と知財・無形資産の活用を基本方針に、取り組みを推し進めていきます。

2035年3月期には売上高500億円、 営業利益175億円、当期純利益120億円と、 それぞれ10年間で約2倍の伸びを計画しています。

「2nd stage」では継続的な新製品の開発、付加価値の創造、新市場の開拓によって競争優位性を確保します。さらに「3rd stage」ではコア事業を応用した事業の拡大、新事業創出によって成長を加速させます。今後の成長には、次世代半導体向け表面処理薬品として開発した「TIPHARES(ティファレス)」シリーズ(⇒TOPICS参照)が重要な位置付けとなります。「TIPHARES」シリーズは、2023年末以降、展示会や学会での発表後すでに多数の引き合いをいただいています。お客様の要望に応える製品を提供するためにも積極的に情報収集を行うとともに、これら最先端の領域においても1歩も2歩も先んじた研究開発によって当社薬品を使用していただけよう拡販に努めていきます。一方、装飾分野では、年々環境への配慮に対する要求が強まっています。当社が培ってきた技術を基に、革新的な環境配慮型製品の開発を行い積極的な拡販に努めます。

熊本事業所は 2026年5月に試生産開始を計画 タイ現地法人は約33億円を投資し 新工場を2027年竣工予定

土地代を含め約118億円を投資し、 熊本県上益城郡益城町に新設する熊本事業所は 2025年12月に竣工予定です。

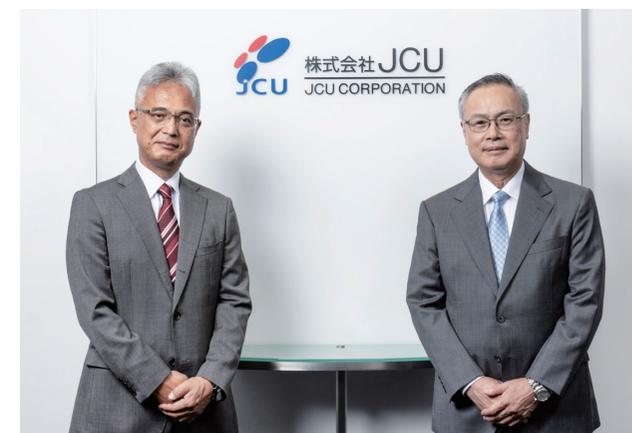
2024年8月に安全祈願祭を行い、工事が本格化しています。予定通り2025年12月に竣工し、2026年5月に試生産を開始する計画です。2021年に生産を開始した中国の湖北工場設立の

経験を活かし、速やかに本生産への移行に取り組みます。日本のシリコンバレーを目指す熊本県に立地することで、情報収集面でも期待しています。熊本事業所はスマートファクトリー、カーボンニュートラル等を見据えた最新鋭の事業所となり、50人規模の新規雇用を見込んでいます。多くの半導体関連企業が進出するため、採用面では苦戦が予想されていますが、積極的なリクルート活動を行い、人材の確保に努めます。

2024年7月にはタイ現地法人が 工場用地取得費用を含め約33億円を投資し、 2027年竣工予定で新工場を建設すると発表しました。

タイはインフラが整備されており、プリント基板を生産しているお客様が多いうえ、自動車関連の産業も活発です。チャイナプラスワンを意図する企業が進出しやすい場所でもあり、近年では電子部品の分野での大型投資が相次いでいます。このような背景から、当社が基盤領域と位置付けているプリント基板の需要拡大が見込まれるため、タイ現地法人にて最新鋭の工場を設立するとともに、サポート体制のさらなる強化を図っていきます。既存の工場と同じ工業団地内で2025年秋に着工し、2027年に竣工予定としています。

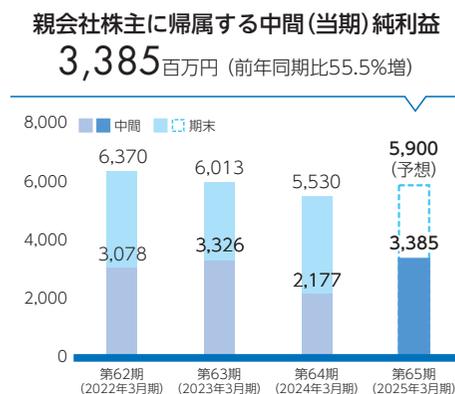
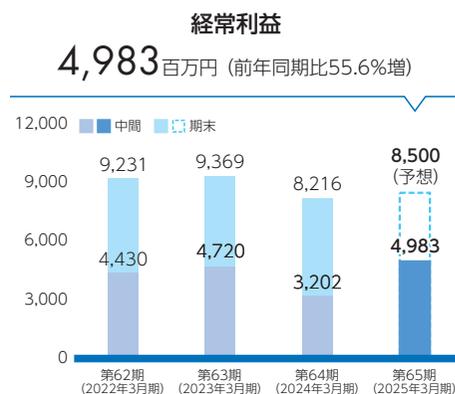
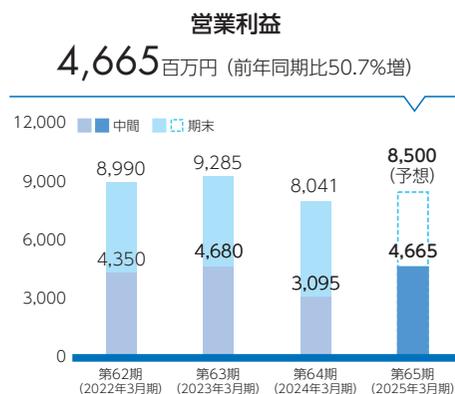
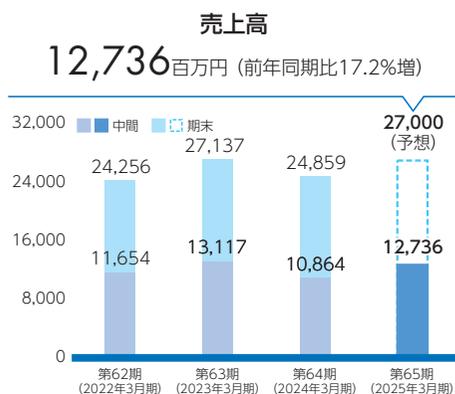
株主・投資家の皆様におかれましては、これまで以上のご愛顧ご支援を賜りますようお願い申し上げます。



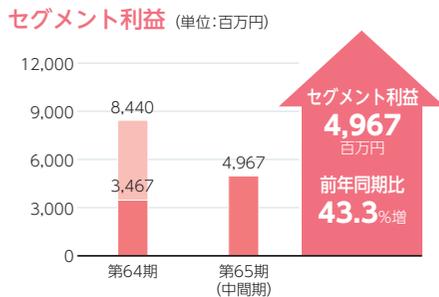
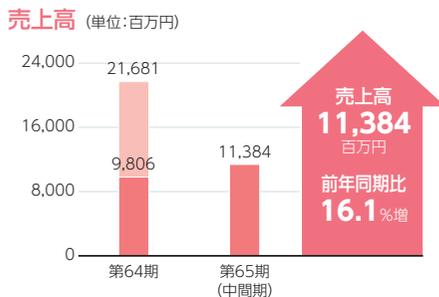
代表取締役会長 兼 CEO
木村 昌志

代表取締役社長 兼 COO
大森 晃久

At a Glance



薬品事業



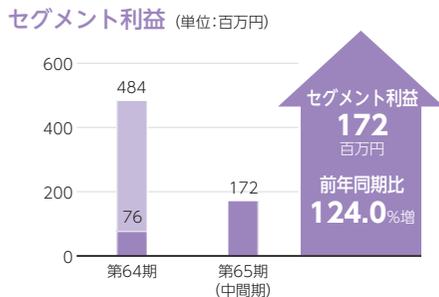
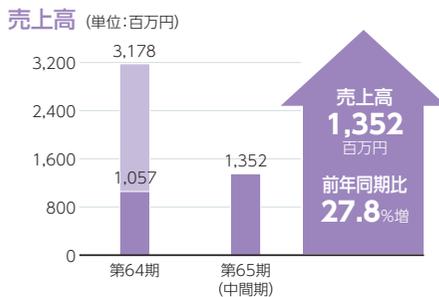
電子分野

- 中国 スマートフォンをはじめとする高機能電子デバイスの在庫調整が一巡したことでプリント基板の需要が回復基調となり、薬品売上高は前年同期比で大幅に増加いたしました。
- 台湾 半導体市場に回復の兆しが見られ、サーバー、高機能電子デバイス向け半導体パッケージ基板の需要が緩やかに拡大したため、薬品売上高は前年同期比で増加いたしました。
- 韓国 半導体市場の底打ちや顧客の在庫調整の進展により半導体パッケージ基板の需要に緩やかな回復が見られ、薬品売上高は前年同期比で増加いたしました。

装飾分野

- 日本 一部自動車メーカーによる出荷停止の影響が緩和されたものの、デザイントレンドの変化に伴う薬品需要の低下もあり、薬品売上高は前年同期比で減少いたしました。
- 中国 半導体・部材不足の緩和に伴い自動車の生産台数は増加したものの、当社が対象とする自動車部品の需要が低下したため、薬品売上高は前年同期比で横ばいに推移いたしました。

装置事業



受注案件が予定通り進行したことで売上高は増加いたしました。大型案件の新規受注が減少したため受注高、受注残高は減少いたしました。

薬品事業

89.4%

セグメント別
業績概況

10.6%

装置事業

薬品事業
使用例



プリント基板



自動車部品

装置事業
製品一例



全自動表面処理装置

● TOPICS 次世代半導体向け表面処理薬品、新ブランド「TIPHARES」のご紹介

当社は、2023年11月に次世代半導体向け表面処理薬品の新ブランド「TIPHARES」を発表しました。

この「TIPHARES」は、次世代半導体を製造する技術である半導体アドバンスドパッケージに使用される表面処理薬品です。

① 半導体アドバンスドパッケージとは？

半導体アドバンスドパッケージとは、半導体における微細化技術の限界を克服するために複数の半導体チップを組み合わせてひとつのパッケージにするための技術のことです。近年では、高機能なCPUやGPUを製造する際に用いられており、AIサーバなどに搭載されています。

② 「TIPHARES」について

「TIPHARES」のブランド名は、ヘブライ語で「美」を表す「TIPHARETH」（ティファレト）の末尾のTHを日本語で「半導体」を表す「Semiconductor」のSに置き換えた造語です。半導体もつ微細かつ複雑な構造の美しさ、高い機能性に本ブランドが将来的に貢献していくことを願って名付けました。「TIPHARES」シリーズは現在、半導体チップ同士を高密度かつ電氣的に配線で接続する銅めっき薬品「TIPHARES RDP」と、不要となるシード層を除去するエッチング薬品「TIPHARES TCE」の2製品の販売を開始しており、今後製品ラインナップを拡充してまいります。

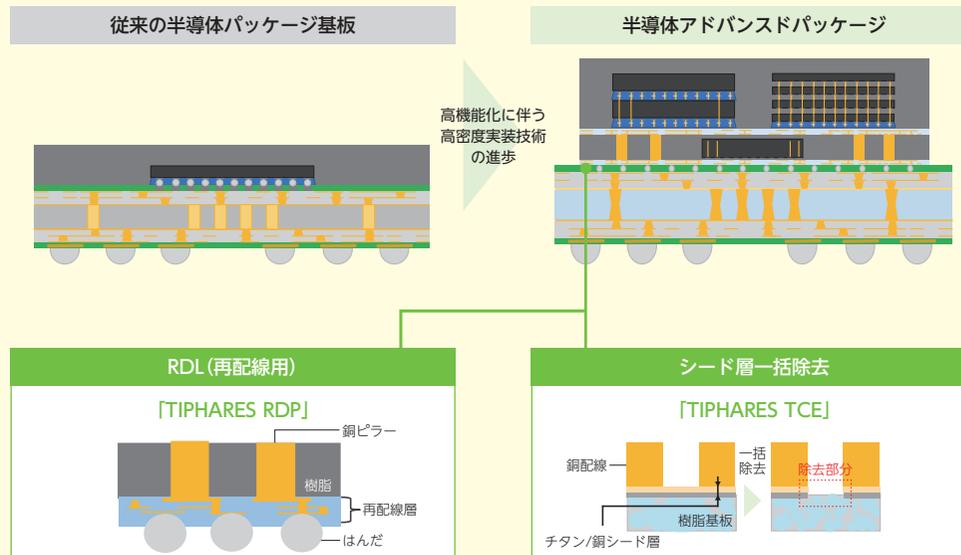
③ 半導体アドバンスドパッケージと「TIPHARES」シリーズ

半導体パッケージには上下に重なった基板同士の接続に用いる穴があり、この穴を通じて配線をつなぎ、電気を通します。その際、穴を銅で埋めると同時に、電気回路の形成も行います。半導体アドバンスドパッケージは従来の半導体パッケージよりも複雑かつ多層的な構造をもつため、非常に細かい回路を均一に配線形成する必要があります。先ほどご紹介した「TIPHARES RDP」は、穴を銅で隙間なく埋める能力や埋めた後の表面の均一性に優れた微細回路が必要とされる半導体アドバンスドパッケージの技術的な要求を満たした表面処理薬品です。「TIPHARES」シリーズは、このように次世代半導体製造に必要なあらゆる表面処理の課題を解決してまいります。

用語解説

半導体チップ	メモリやロジックIC（集積回路）などを組み合わせてパッケージングされた半導体集積回路の総称
CPU	Central Processing Unitの略称、データの演算やコンピュータ内の装置の制御などを行う装置
GPU	Graphic Processing Unitの略称、画像描写を行う際に必要となる計算処理を行う装置
銅めっき薬品	化学反応もしくは電気を用いて、金属等の素材の表面を銅で被覆させるための薬品
エッチング薬品	薄いシード層（銅）を化学反応によって剥がし、指定されたパターンの形にするための薬品
シード層	絶縁体の樹脂上にめっき技術を用いて銅配線を形成する際に必要となる薄い金属層

● 半導体アドバンスドパッケージにおける「TIPHARES」シリーズ利用イメージ



RDL (Redistribution layer)

半導体デバイスの性能向上や効率的な接合を図るため、デバイス内部の配線を再配置する配線層

シード層除去

不要となったシード層（用語解説参照）を化学薬品で除去し、指定された配線パターンを形成する工程

④ 「TIPHARES」シリーズの今後

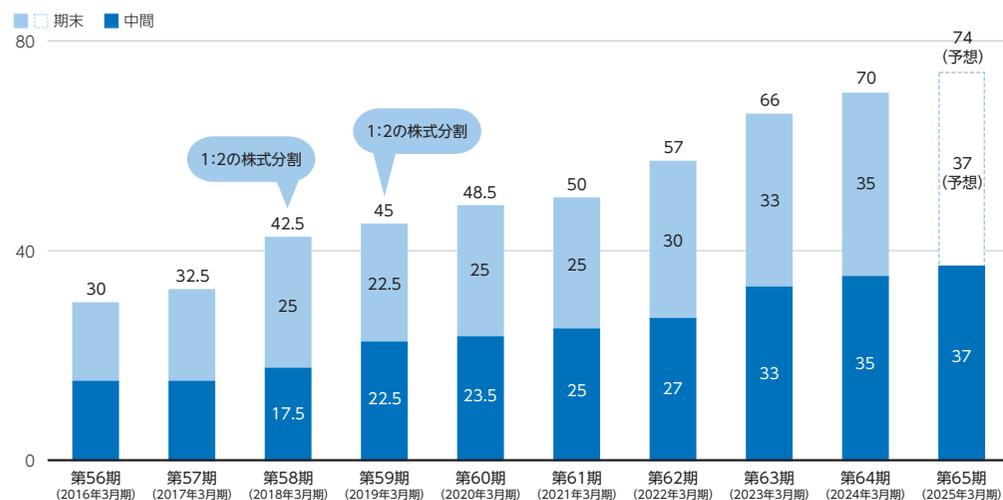
半導体アドバンスドパッケージはAIサーバをはじめとした最先端電子機器を中心に搭載されるなど、私達の暮らしに必要な不可欠な技術であり、今後大きく発展することが予想される分野です。当社はこの半導体アドバンスドパッケージの領域を次世代領域と位置付けており、2025年12月に竣工を予定している熊本事業所では、「TIPHARES」シリーズをはじめ次世代半導体向け表面処理薬品の研究開発をさらに強化してまいります。AIの台頭で、より高機能化かつ高効率化を実現する次世代技術が求められる中、当社は「TIPHARES」シリーズの研究開発を通じ世の中のテクノロジーの進歩に貢献してまいります。

● 株主還元について

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付け、中期経営計画「JCU VISION 2035 -1st stage-」（2025年3月期～2027年3月期）の資本政策において株主還元方針を次のとおり定めております。

- 総還元性向：50%を目安
- 安定的な増配
- 機動的な自己株式取得の検討

配当金 (円)



(注) 2017年4月1日付、2018年4月1日付でそれぞれ普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2019年3月期以前については、当該分割後を基準に算出した数値を表示しております。

配当金を配当金領収証でお受取りの株主様へ

配当金を配当金領収証でお受取りの株主様には、より安全、確実かつ迅速に配当金をお受取りいただける預金口座や証券会社の口座への振込みによる配当金のお受取りをお勧めいたします。詳しくはお取引のある証券会社等にお問い合わせください。



株式会社 JCU

〒110-0015 東京都台東区東上野四丁目8番1号 TIXTOWER UENO 16階
TEL: 03-6895-7001 FAX: 03-6895-7021
<https://www.jcu-i.com/>

● サステナビリティレポート2024の発行

JCUグループの持続可能性についての考え方や取り組みをステークホルダーの皆様にお伝えすることを目的にサステナビリティレポートを発行しております。

サステナビリティレポート2024では、JCUグループの価値創造プロセスをひもとき、事業を通じたESGへの取り組みを具体的に紹介しております。また、取締役へのインタビューを拡充し、各事業部門の考え方、さらには、財務・資本戦略について掲載いたしました。当社は、本レポートなどの発行物や対話の機会を通じて説明責任を果たし、企業価値の向上につなげてまいります。

本レポートの報告対象期間は2023年4月1日から2024年3月31日までとなっております。当社ウェブサイトよりダウンロードが可能となっております。当社への理解をより深めていただけるような内容となっておりますので、ぜひご覧ください。



サステナビリティレポート 2024

株式会社 JCU
JCU CORPORATION

SUSTAINABILITY
REPORT 2024

表面処理技術から未来を創造する
Explorer in Surface Engineering



見やすく読みましがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。